

所在地	東京都墨田区八広 4-39-7
事業内容	金属加工
資本金額	2000 万円
創業	1978 年
従業員数	53 人
自社紹介	各種装置・機械の設計開発、架台・筐体設計・製作、精密板金加工・レーザー加工、金属プレス金型設計・製作、金属プレス加工、切削加工・機械加工、複合加工、各種アッセンブリ加工、ラピッドマニファクチャリング（3D プリンター・レーザーカッター・CNC 加工・UV プリント・3D スキャン・3D データ作成）
U R L	https://hamano-products.co.jp/

商談する受注側企業に求める技術や条件、認証など

板金加工、切削加工、プレス加工、表面処理など金属加工全般

調達希望案件①

用途・品目	半導体装置部品
材質	ステンレス・鉄
形状・寸法	500×500
加工内容	板金加工
必要な設備	レーザー、ベンダ、溶接
数量	1～50 個

調達希望案件②

用途・品目	半導体装置部品
材質	ステンレス、鉄、アルミ
形状・寸法	200×200×200
加工内容	切削加工
必要な設備	マシニング、旋盤
数量	1～20 個

調達希望案件③

用途・品目	ロボット関連部品
材質	ステンレス、鉄
形状・寸法	300×300
加工内容	板金加工（絞り加工）
必要な設備	レーザー、ベンダ、溶接
数量	1～20 個

調達希望案件④

用途・品目	筐体関係
材質	鉄
形状・寸法	500×500×1500
加工内容	板金、溶接、塗装
必要な設備	レーザー、ベンダ、溶接、塗装
数量	10～50 個